

# Produktbeschreibung

## Schnelle Details

|                        |                                                          |                        |                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Herkunftsort           | Guangdong China (Festland)                               | Markenname             | O-Führung                  |
| Basismaterial          | FR-4, Aluminium                                          | Kupfer Dicke           | 0.5oz-5oz                  |
| Mindest. Lochgröße     | 0,2 mm                                                   | Mindest. Linienbreite  | 0,2 mm                     |
| Oberflächenbearbeitung | Immersion Gold, OSP, bleifrei HASL                       | Plattendicke           | 0,1-5mm                    |
| anwendbar auf          | LED, Mobiltelefon, Klimaanlage, Waschmaschinen           | Charakter              | Industrielle Steuerplatine |
| Zertifikate            | ISO9001, UL, RoHS, SGS                                   | Q / CTN                | 10PCS-100PCS               |
| Gewicht                | 0,01 kg -5 kg                                            | MOQ                    | 10 Stück                   |
| Modell-Nr              | Power Bank<br>Leiterplattenbestückung pcha<br>Hersteller | Mindest. Zeilenabstand | 0,2 mm                     |
| Farbe                  | blau, rot, grün, schwarz                                 | Preis                  | \$ 0,1- \$ 10              |
| Design-Typ             | Kundenanforderung                                        | Größe                  | 0,01 m 3 bis 10 m 3        |

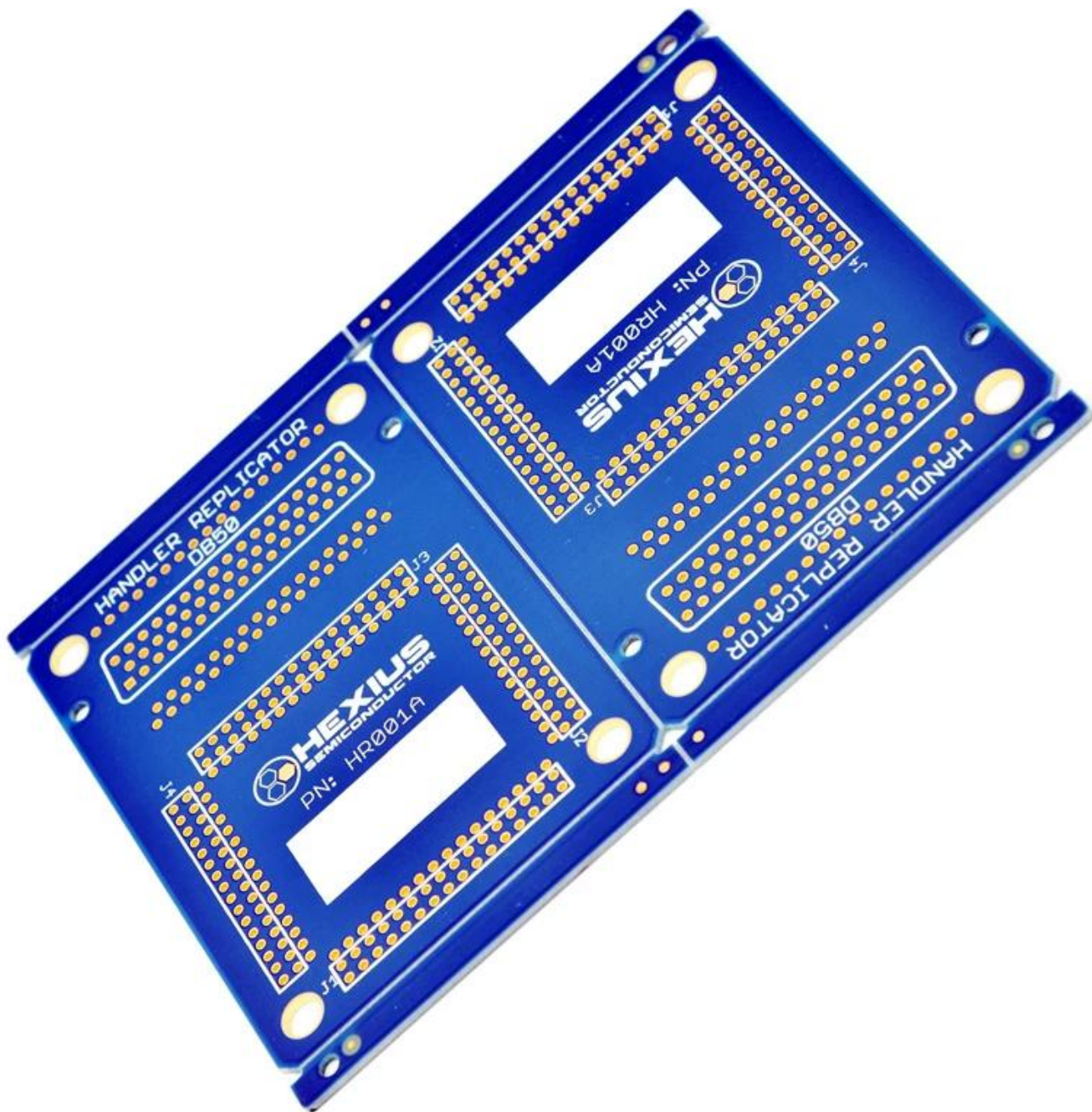
## Verpackung & Lieferung

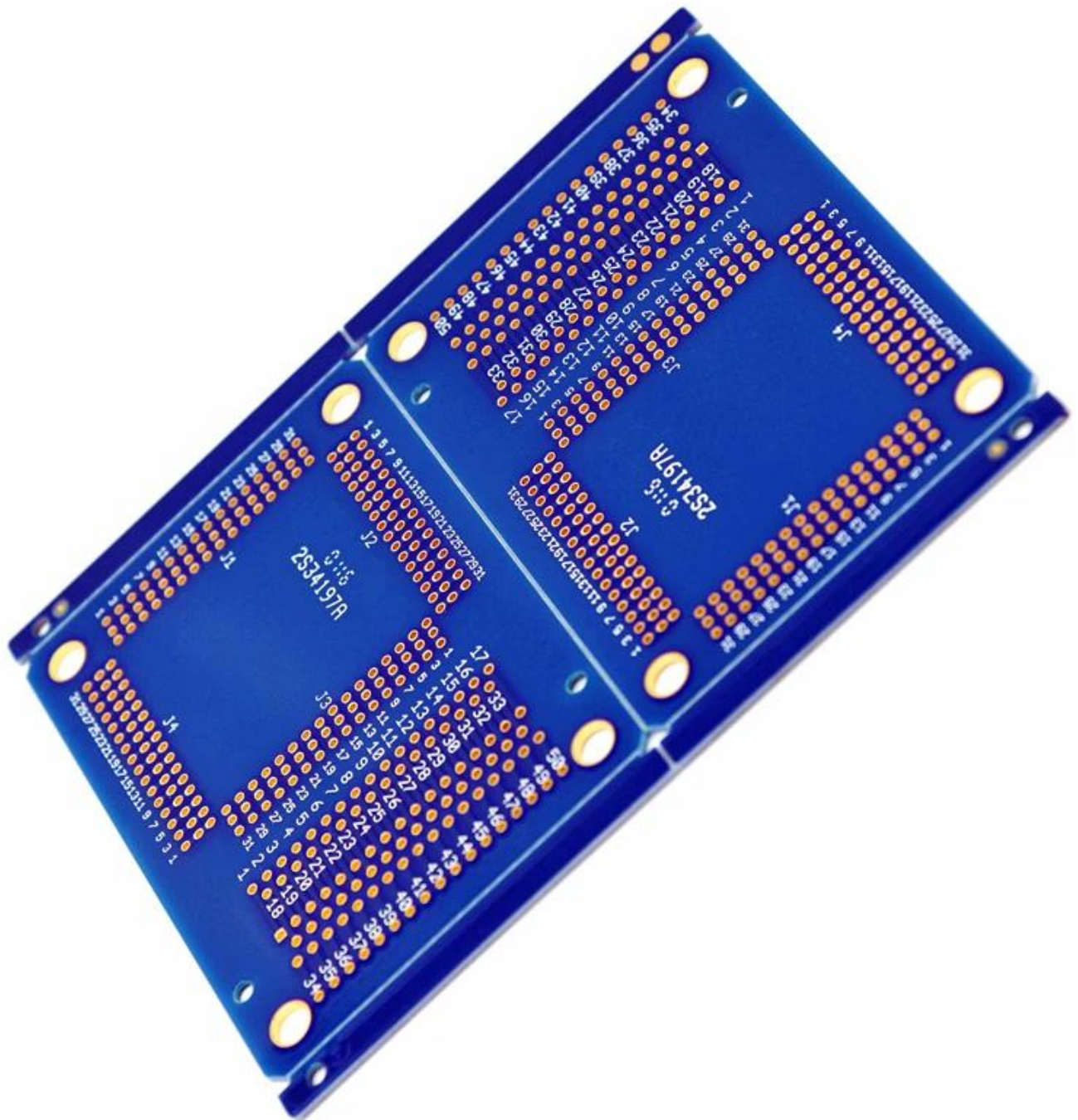
|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Verpackungsinformationen | 16 Jahre professionelle OEM Leiterplattenhersteller |
| Lieferdetails            | 7-12days                                            |

## Produktbeschreibung

### 16 Jahre professionelle OEM-Leiterplattenfertigung

| Artikel                                | 2014                                                                                                                                                          |           | 2015 ~ 2016 |           | 2017 ~ 2018 |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                        | Volumen                                                                                                                                                       | Probe     | Volumen     | Probe     | Volumen     | Probe     |
| Anzahl der Ebenen                      | 32                                                                                                                                                            | 42        | 38          | 44        | 42          | 48        |
| Min Linie / Abstand (µm)               | 50/50                                                                                                                                                         | 40/45     | 40/45       | 40/40     | 35/40       | 35/35     |
| Min. Bohrloch Durchmesser (mm)         | 0,15                                                                                                                                                          | 0.10      | 0,15        | 0.10      | 0,15        | 0.10      |
| Seitenverhältnis von PTH               | 14: 1                                                                                                                                                         | 16: 1     | 16: 1       | 18: 1     | 18: 1       | 20: 1     |
| N + C + N                              | 4 + C + 4                                                                                                                                                     | 5 + C + 5 | 5 + C + 5   | 6 + C + 6 | 5 + C + 5   | 6 + C + 6 |
| Irgendeine Schichtverbindung           | 5 + 2 + 5                                                                                                                                                     | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5   | 6 + 2 + 6 | 5 + 2 + 5   | 6 + 2 + 6 |
| Plattenfüllung via                     | JA                                                                                                                                                            | -         | JA          | -         | JA          | -         |
| Mindest. Kerndicke (ohne Kupfer) (µm)  | 50                                                                                                                                                            | 40        | 40          | 30        | 40          | 30        |
| Mindest. Laser Bohrdurchmesser (µm)    | 75                                                                                                                                                            | 65        | 65          | 50        | 50          | 40        |
| Via auf begraben Loch / gestapelt über | JA                                                                                                                                                            | -         | JA          | -         | JA          | -         |
| Material                               | FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Schweres Kupfer, usw.                                                                                                            |           |             |           |             |           |
| Eingebettete Kondensator-Leiterplatte  | JA                                                                                                                                                            | -         | JA          | -         | JA          | -         |
| Oberflächenprozess                     | Bleifrei HASL, ENIG, OSP, Immersion Silber, Eintauchzinn, Flash-Gold, Gold-Finger-Beschichtung, selektive Hartvergoldung, Peelable Lötmaske, Kohlenstofftinte |           |             |           |             |           |





**Ursprungsland:**

[Leiterplattenhersteller im Porzellan, Kundenspezifisches China](#)